



	管、汇丰前海证券、泰康保险（香港）、华融证券、上海理成资产、奥士康、招商证券、国金证券、高信百诺、星云投资、百年保险资管、太平洋证券、进化论资产、保银投资、太平资产、China Alpha、Point72 Asset Management、安信证券、民生证券、霄沣投资、上海尚近投资、新华资产、南土资产、人保资产、凯丰投资、正奇控股、长城基金、申万宏源、中信证券、兴业证券、光大证券、万和证券、LIBRARYGROUP、中国人寿、煜诚投资、建信投资、上汽顾臻、杭州萧山泽泉投资、招商信诺、中海外钜融资产、开源证券、广发证券资管、北京致顺投资、个人投资者（排名不分先后）
时间	2022年8月26日、2022年8月29日
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：蒋威 证券投资部：陈小曼、王渝、肖晓月、陈卓璜
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、简要介绍公司 2022 年上半年经营情况</b></p> <p>2022 年上半年，公司实现营业收入 269,539.70 万元、同比增长 13.71%；归属于上市公司股东的净利润 35,943.16 万元、同比增长 26.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,122.02 万元、同比下滑 5.47%；总资产 975,051.54 万元、较上年末增长 17.44%；归属于上市公司股东的净资产 400,039.03 万元、较上年末增长 6.33%。报告期内，公司营业收入平稳增长，IC 封装基板、半导体测试板、PCB 业务分别同比增长 26.80%、12.09%、12.15%。</p> <p>报告期内，公司围绕既定的战略方向，一方面加快投资扩产力度，全面推进 IC 封装基板、PCB 高端样板和高多层板的投资扩产工作；另一方面持续深入推进组织变革、数字化改造和降本增效工作，加强对一线业务部门的支持力度和资源投入，持续聚焦客户满意度提升和大客户突破，实现主营业务收入的平稳增长和利润稳定。报告期内员工持股计划的费用摊销，FCBGA 封装基板项目的人工成本以及珠海兴科投产初期的亏损，对整体经营利润造成拖累，导致扣除非经常性损益的净利润同比有所下降。</p> <p>展望未来，经济增长依旧承压，下游需求相对疲弱，疫情时有反复，公司的经营和增长压力仍旧存在。但公司的战略方向依然明确：公司将在坚守线路板产业链的前提下，稳步推动 CSP 和 FCBGA 封装基板项目的</p>

投资扩产，并继续投入持续优化改善组织变革、数字化改造和降本增效等基础工作。

## 二、公司坚持选择 IC 封装基板赛道的原因

进入 IC 封装基板领域，是公司坚持走技术升级道路的必然选择。公司在封装基板领域已积累了丰富的经验(2012 年开始进入 IC 封装基板领域，2018 年实现满产，2019 年实现财务层面盈利)，且已通过三星认证，从侧面说明了公司的体系、能力、技术都得到了头部客户的认可。

2021 年全球 IC 封装基板行业规模达到 144 亿美金，同比增速超 40%，IC 封装基板已超过软板成为线路板行业中规模最大、增速最快的细分子行业。IC 封装基板和半导体测试板是芯片制造和测试的关键材料，未来国内晶圆和封测产能持续扩产必将带动 IC 封装基板和半导体测试板行业需求的增长，行业赛道好，玩家少。

BT 封装基板目前国内仅有少数几家公司具备量产能力和稳定的客户资源，兴森科技就是其中一家。FCBGA 封装基板目前国内暂无量产企业，公司已完成团队组建，并同步启动设备采购和政府主管部门的审批备案，开始投资建设 FCBGA 封装基板项目。未来公司将稳步推动 CSP 和 FCBGA 封装基板项目的投资扩产，逐步提升半导体业务的收入和利润占比。

## 三、珠海兴科项目目前建设进度介绍

珠海兴科项目已于今年二季度建成 1.5 万平方米/月的新产能，三季度开始量产爬坡。

## 四、IC 封装基板下游市场及客户分布情况介绍

公司 FCBGA 封装基板项目仍在建设过程中，尚未投产，预计珠海 FCBGA 封装基板项目于 2022 年底之前完成产线建设，2023 年一季度进入样品试产阶段，三季度开始进入小批量试生产阶段。目前公司 IC 封装基板业务以 CSP 封装基板、BT 材料为主，存储类载板是 CSP 封装基板领域最大的下游市场，也是公司目前主要目标市场。公司的下游应用占比如下：存储类占比约 2/3，指纹识别芯片、射频芯片、应用处理器芯片、传感器芯片等其他相关占比约 1/3，预计未来将维持前述产品结构。客户占比情况如下：国内客户占比约 2/3，中国台湾客户和韩系客户合计占比约 1/3，下游国内厂商正在积极扩产，是未来的主要增量市场所在。

## 五、半导体测试板业务介绍

半导体测试板是芯片测试环节的基础耗材，产品应用从晶圆测试到封装后芯片测试各环节，产品类型包括探针卡、负载板和老化板。测试板业务与样板业务经营模式类似，属于多品种、小批量、定制化生产模式，产品单价和附加值较高。目前国内参与企业较少，公司半导体测试板业务在国内规模领先，公司半导体测试板业务的主要经营主体为子公司美国 Harbor 及广州科技，Harbor 在全球半导体测试板整体解决方案领域具有优势地位，主要客户均为全球一流半导体公司。广州科技测试板扩产目标是建设国内最大的专业化测试板工厂，并为美国 Harbor 提供产能支持。

2022 年上半年公司半导体测试板业务实现营收 22,801.70 万元、同比增长 12.09%；毛利率 20.76%、同比下降 1.41 个百分点。未来随着广州科技产能逐步释放，产品良率、交期、技术能力等稳定提升，预计下半年将持续改善。

#### 六、公司未来的战略方向

展望未来，经济增长依旧承压，公司在面临需求端通缩叠加成本端通胀压力的情况下，战略方向依然明确：

(1) 在坚守线路板产业链的前提下，持续加大研发投入以实现技术、产品、客户的持续升级，通过良率、交付、技术的改善提升客户满意度，并最终强化与核心大客户的合作深度和广度。

(2) IC 封装基板业务依旧是公司的战略方向，稳步推动 CSP 和 FCBGA 封装基板项目的投资扩产，从技术能力、产能规模上追赶海外同行，并最终实现公司整体收入和利润规模的跨越式增长。

(3) 组织变革、数字化改造和降本增效等基础工作是功夫在平时、收益在未来，是管理能力和经营效率提升的基础所在，也是在规模增长之外持续增长的潜力所在，仍旧会继续投入并持续改善优化。

附件清单	无
日期	2022 年 8 月 30 日